

中信建投证券股份有限公司
关于上海艾为电子技术股份有限公司
2026年半年度持续督导跟踪报告

保荐人名称：中信建投证券股份有限公司	被保荐公司名称：上海艾为电子技术股份有限公司
保荐代表人姓名：张铁	联系方式：021-68801592 联系地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔2203室
保荐代表人姓名：杜登瑞	联系方式：021-68801584 联系地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔2203室

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2021〕1953号文”批准，上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“艾为电子”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,180万股。本次公司发行新股的发行价为76.58元/股，募集资金总额为人民币320,104.40万元，扣除发行费用16,578.26万元后，实际募集资金净额为人民币303,526.14万元。本次公开发行股票于2021年8月16日在上海证券交易所上市，并由中信证券股份有限公司担任保荐人。

经中国证监会“证监许可〔2025〕2972号文”批准，艾为电子向不特定对象发行19,013,200张可转换公司债券，每张面值人民币100元，期限6年，募集资金总额为人民币190,132.00万元，扣除尚未支付的保荐承销费1,230.92万元（不含税），另扣除其他发行费用274.30万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币188,626.78万元。本次发行证券于2026年2月26日在上海证券交易所上市。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）担任本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，并于2025年9月17日与公司签订保荐协议。

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐人，由另行聘请的保荐人完成原保荐人尚未完成的持续督导工作。因此，自公司与中信建投证券签订保荐协议之日起，中信证券股

份有限公司尚未完成的持续督导工作由中信建投证券承接。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信建投证券履行持续督导职责，并出具本2026年半年度持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	保荐机构、保荐代表人应当协助和督促上市公司建立相应的内部制度、决策程序及内控机制，以符合法律法规和上市规则的要求，并确保上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、核心技术人员知晓其在本规则下的各项义务。	保荐机构、保荐代表人已协助和督促艾为电子建立相应的内部制度、决策程序及内控机制，以符合法律法规和上市规则的要求，并确保艾为电子及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、核心技术人员知晓其在本规则下的各项义务。
2	保荐机构、保荐代表人应当持续督促上市公司充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，并确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。 保荐机构、保荐代表人应当对上市公司制作信息披露公告文件提供必要的指导和协助，确保其信息披露内容简明易懂，语言浅白平实，具有可理解性。 保荐机构、保荐代表人应当督促上市公司控股股东、实际控制人履行信息披露义务，告知并督促其不得要求或者协助上市公司隐瞒重要信息。	保荐机构、保荐代表人已持续督促艾为电子充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，并确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。 保荐机构、保荐代表人已对艾为电子制作信息披露公告文件提供必要的指导和协助，确保其信息披露内容简明易懂，语言浅白平实，具有可理解性。 保荐机构、保荐代表人已督促艾为电子控股股东、实际控制人履行信息披露义务，告知并督促其不得要求或者协助艾为电子隐瞒重要信息。
3	上市公司或其控股股东、实际控制人作出承诺的，保荐机构、保荐代表人应当督促其对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露。 保荐机构、保荐代表人应当针对前款规定的承诺披露事项，持续跟进相关主体履行承诺的进展情况，督促相关主体及时、充分履行承诺。 上市公司或其控股股东、实际控制人披露、履行或者变更承诺事项，不符合法律法规、上市规则以及上海证券交易所其他规定的，保荐机构和保荐代表人应当及时提出督导意见，并督促相关主体进行补正。	保荐机构、保荐代表人已督促艾为电子对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露。 保荐机构、保荐代表人已持续跟进相关主体履行承诺的进展情况，督促其及时、充分履行承诺。 保荐机构、保荐代表人未发现艾为电子披露、履行或者变更承诺事项存在不符合法律法规及其他相关规定的情形。

序号	工作内容	持续督导情况
4	保荐机构、保荐代表人应当督促上市公司积极回报投资者，建立健全并有效执行符合公司发展阶段的现金分红和股份回购制度。	保荐机构、保荐代表人已督促艾为电子积极回报投资者，建立健全并有效执行符合公司发展阶段的现金分红和股份回购制度。
5	保荐机构、保荐代表人应当持续关注上市公司运作，对上市公司及其业务有充分了解；通过日常沟通、定期回访、调阅资料、列席股东会等方式，关注上市公司日常经营和股票交易情况，有效识别并督促上市公司披露重大风险或者重大负面事项。 保荐机构、保荐代表人应当核实上市公司重大风险披露是否真实、准确、完整。披露内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，保荐机构、保荐代表人应当发表意见予以说明。	保荐机构、保荐代表人持续关注艾为电子运作，对艾为电子及其业务有充分了解；通过日常沟通、定期或不定期回访、调阅资料、现场检查等方式，关注艾为电子日常经营和股票交易情况，对艾为电子开展持续督导工作。 经核查，本持续督导期内，艾为电子不存在应披露而未披露的重大风险或者重大负面事项。艾为电子不存在对持续经营能力、核心竞争力或者控制权稳定性有重大不利影响的风险或者负面事项。
6	上市公司股票交易出现严重异常波动的，保荐机构、保荐代表人应当督促上市公司及时按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》履行信息披露义务。	本持续督导期间，艾为电子股票交易未出现严重异常波动情形。
7	保荐机构、保荐代表人应当督促控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及核心技术人员履行其作出的股份减持承诺，关注前述主体减持公司股份是否合规、对上市公司的影响等情况。	保荐机构、保荐代表人已督促控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及核心技术人员履行其作出的股份减持承诺，持续关注前述主体减持公司股份是否合规、对上市公司的影响等情况。
8	保荐机构、保荐代表人应当关注上市公司使用募集资金的情况，督促其合理使用募集资金并持续披露使用情况。	保荐机构、保荐代表人对艾为电子募集资金的使用以及募集资金投资项目的实施情况进行了持续关注，并对募集资金存放、管理与实际使用情况进行了现场检查。

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

在本持续督导期间，保荐人和保荐代表人未发现艾为电子存在重大问题。

三、重大风险事项

（一）技术迭代风险

公司所处的集成电路设计行业为典型的技术密集型行业，技术的升级与产品的迭代速度快，同时芯片产品拥有较高的技术壁垒且先发企业的优势明显。如果

公司在后续研发过程中对市场需求判断失误或研发进度缓慢，将面临被竞争对手抢占市场份额的风险。此外，高端芯片研发存在开发周期长、资金投入大、研发风险高的特点，在研发过程中很可能存在因某些关键技术未能突破或者产品性能、参数、良率等无法满足市场需要而研发失败、落后于新一代技术的风险。

由于公司下游终端客户多为知名品牌客户，其产品系列齐全，对公司产品型号有相对长期的使用需求，因此，公司大部分主要型号产品在上市后拥有5年以上的生命周期。如果公司不能根据行业及客户需求保持较快的技术迭代，不能保持持续的创新能力及贴紧下游应用的发展方向，并持续推出具有竞争力的新产品，将导致公司市场竞争力下降，并给公司未来业务拓展和经营业绩带来不利影响。

（二）经营风险

1、下游需求波动风险

公司产品为通用型芯片，下游客户及应用场景覆盖消费电子、工业互联、汽车等多个领域。下游市场需求受宏观经济环境变化、细分行业景气度周期波动、下游客户需求结构调整等多重因素影响，存在一定的周期性与不确定性。若未来宏观经济承压、下游相关行业景气度出现下行，或核心客户的需求规划与产品结构发生不利变动，可能引致公司订单规模收缩、盈利空间收窄，进而对公司未来的持续盈利能力产生不利影响。

2、市场竞争风险

集成电路行业受国家政策鼓励且发展迅速，行业内企业逐渐增多。一方面，行业内厂商在巩固自身优势基础上积极进行市场拓展；另一方面，新进入厂商也不断抢夺市场份额，市场竞争逐渐加剧。若公司不能正确把握市场动态和行业发展趋势，不能根据客户需求及时进行技术和产品创新，则公司的行业地位、市场份额、经营业绩等可能受到不利影响。

此外，相较于公司现有近1,900款芯片产品型号，同行业集成电路国际巨头，如TI和ADI，拥有上万种芯片产品型号，涵盖了下游大部分应用领域。一旦国际巨头企业采取强势的市场竞争策略与公司同类产品进行竞争，将会对公司造成较大的竞争压力，如公司不能实施有效的应对措施，及时弥补竞争劣势，将对公司

的竞争地位、市场份额和经营业绩造成不利影响。

（三）财务风险

1、毛利率波动风险

近年来，集成电路设计行业受到社会、市场和资本的关注度不断提高，竞争逐步加剧。国际方面，公司与同行业龙头企业相比，公司某些产品在产品布局的丰富程度、工艺制程与性能表现等技术指标的先进程度、经营规模或市场占有率的领先程度上存在较大差距；在国内方面，公司各条产品线所面对的竞争对手也在逐渐增多。公司产品的终端应用领域具有市场竞争较为激烈的特点。为维持较强的盈利能力，公司必须根据市场需求不断进行产品的迭代升级和创新。如若公司不能采取有效措施以巩固和增强产品竞争力，公司综合毛利率将面临下降的风险，进而造成公司在激烈的市场竞争中处于不利地位，降低持续盈利能力。

2、存货规模较大及跌价风险

公司存货主要由原材料、委托加工物资、库存商品构成。本报告期末，公司存货账面价值为64,785.87万元，较2025年末存货账面价值下降0.94%；公司根据存货的可变现净值低于成本的金额计提相应的跌价准备，报告期末公司存货跌价准备余额8,526.20万元；若未来市场环境发生变化、竞争加剧或技术更新导致存货产品滞销、存货积压，将导致公司存货跌价风险增加，对公司的盈利能力产生不利影响。

3、汇率波动风险

因公司的海外业务通常以美元进行计价并结算，子公司艾唯技术有限公司（AWINIC TECHNOLOGY LIMITED）记账本位币为美元，同时公司存在较多的境内外母子公司关联交易，汇率波动将会对公司汇兑损益及其他综合收益——外币报表折算差造成影响。报告期内，公司汇兑损失金额为2,164.46万元，主要系外币交易过程中产生的已实现汇兑损益和期末持有的外币资产负债因汇率变动产生的未实现汇兑损益；报告期末，公司其他综合收益——外币报表折算差额为3,151.54万元，主要系子公司艾唯技术有限公司（AWINIC TECHNOLOGY LIMITED）的外币报表折算差及母子公司之间关联交易产生的汇率折算差。如果

未来汇率出现大幅波动或者我国汇率政策发生重大变化，将造成公司经营业绩及所有者权益的波动。

（四）行业风险

公司是集成电路设计企业，主要从事集成电路芯片产品的设计、研发及销售，属于集成电路行业的上游环节。全球集成电路行业在近些年来一直保持稳步增长的趋势，但由于该行业是资本及技术密集型行业，随着技术的更迭，行业本身呈现周期性波动的特点，并且行业周期的波动与经济周期关系紧密。如果宏观经济发生剧烈波动或存在下行趋势，将导致行业发生波动或需求减少，使包括公司在内的集成电路企业面临一定的行业波动风险，对经营情况造成一定的不利影响。

（五）宏观风险

国际贸易环境对公司经营影响较大的风险。近年来国际贸易环境不确定性增加，逆全球化贸易主义进一步蔓延，部分国家采取贸易保护措施，屡屡采取长臂管辖措施，对我国集成电路产业有所冲击。集成电路行业具有典型的全球化分工合作特点，若国际贸易环境发生重大不利变化、各国与各地区间贸易摩擦进一步升级、全球贸易保护主义持续升温，则可能对包括公司在内的集成电路产业链上下游公司的生产经营产生不利影响，造成产业链上下游交易成本增加，从而可能对公司的经营带来不利影响。

四、重大违规事项

在本持续督导期间，艾为电子不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

公司主要财务数据如下所示：

单位：元

主要会计数据	2026年1-6月	2025年1-6月	本期比上年同期增减（%）
营业收入	1,350,429,235.14	1,369,558,110.54	-1.40
利润总额	83,710,689.73	152,784,081.67	-45.21
归属于上市公司股东的净利润	94,872,384.39	156,521,550.89	-39.39

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,556,180.36	122,832,448.30	-91.41
经营活动产生的现金流量净额	2,084,519.56	78,752,102.51	-97.35
主要会计数据	2026年6月末	2025年12月末	本期末比上年度末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产	4,253,698,361.81	4,196,243,546.50	1.37
总资产	7,243,131,370.88	5,302,026,798.17	36.61

公司主要财务指标如下所示：

主要财务指标	2026年1-6月	2025年1-6月	本期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.41	0.67	-38.81
稀释每股收益（元/股）	0.41	0.67	-38.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.05	0.53	-90.57
加权平均净资产收益率（%）	2.24	3.91	减少1.67个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.25	3.07	减少2.82个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	20.87	19.20	增加1.67个百分点

2026年1-6月，公司主要财务数据及指标变动的原因如下：

1、报告期内，利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别同比下降45.21%、39.39%、91.41%，主要系：（1）报告期内，公司收入增速有所放缓，主要系两方面因素所致：其一，全球存储芯片呈现阶段性供给偏紧态势，智能手机等终端厂商受存储芯片供货节奏制约，整机排产及出货节奏有所放缓，公司消费类及AIoT领域模拟芯片市场竞争压力有所加大；其二，为巩固现有市场份额、加快新客户拓展落地，公司阶段性优化产品结构，短期内对当期收入增长及综合毛利率形成一定影响，但为公司长期发展奠定了坚实基础；（2）报告期内新增可转换公司债券利息1,512.52万元，同时受美元汇率波动影响，报告期内产生汇兑损失2,164.46万元，导致报告期内财务费用同比增加；（3）报告期内加大了研发投入，职工薪酬及工程开发费有所增长。

2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降97.35%，主要系公司生产采购支出增长、研发人员增长对应的职工薪酬支出增长，导致经营活动现金流出增幅超过销售回款及其他经营现金流入增幅。

3、总资产较上年度末增长36.61%，主要系报告期内发行的可转换公司债券募集的资金到账所致。

4、报告期内归属于上市公司基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益分别同比下降38.81%、38.81%、90.57%，主要系受净利润下降的影响所致。

六、核心竞争力的变化情况

公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

（一）领先的核心技术优势

1、技术积累丰富，具备持续创新能力

公司技术、客户、供应链、人才等多项优势紧密结合、发展迅猛。技术方面，公司积累了大量模拟芯片设计开发经验，截至2026年6月30日，公司及控股子公司累计获得发明专利542项，实用新型专利241项，外观设计专利9项，软件著作权139项，集成电路布图登记642项。

2、产品领域延伸性强，响应国产化替代需求

公司秉持现代化的集成电路工艺和设计理念，在集成电路设计领域积累了大量的技术经验。公司在数模混合信号链领域深耕多年，紧跟核心电子产品的发展趋势、持续进行产品创新。公司从高性能数模混合信号芯片、电源管理芯片、信号链芯片产品出发，陆续拓展丰富子类产品线，各类产品技术持续发展，形成了丰富的技术积累及较强的技术竞争力，积极覆盖新智能硬件的国产化替代需求。

3、细分市场具备较强的产品和技术优势

公司主要产品包括高性能数模混合信号芯片、电源管理芯片、信号链芯片等，在各个细分市场中均具备自身独特的竞争优势。其中，公司在高性能数模混合信号芯片领域形成了丰富的技术积累和完整的产品系列，发展出集硬件芯片和软件

算法为一体的音频解决方案；在马达驱动芯片领域较早地进行了技术研发及积累，品类不断丰富，在国内企业中具有较强的先发竞争优势，特别是在Haptic触觉反馈和Camera AF&OIS领域。在电源管理芯片和信号链芯片领域持续扩充产品种类，并在下游应用市场持续进行拓展。

（二）人才团队优势

集成电路设计属于智力密集型行业，人才是集成电路设计企业的最关键要素。公司高度重视研发和管理人才的培养，积极引进国内外高端技术人才，目前已建立了成熟稳定的研发和管理团队。截至2026年6月30日，公司共有技术人员726人，占全部员工人数的比重达74.85%，主要研发和技术人员平均拥有十年以上的工作经验；共有核心技术人员5人，领导并组建了由多名集成电路设计行业资深人员组成的技术专家团队，构成公司研发的中坚力量。

公司重视人才管理体系建设，在人才管理职业发展通道、薪酬激励体系、干部管理体系、招聘管理等系统及建设方面起步早，保持行业领先。公司制定了员工职级职等管理政策、干部管理政策、技术职位任职资格管理体系等一系列人才培养政策。公司持续引入行业顶尖人才，关注处于不同职业阶段的员工能力提升，加速人才体系化建设，为企业技术创新发展提供了持续的人才资源，实现人力资源的合理配置与科学化管理，打造支撑公司长期发展的组织能力和人才梯队，全面提升企业竞争力。此外，公司优质的人才保障制度和文化氛围，不断增强创新人才吸引力和凝聚度，支撑公司持续创新。

（三）产品市场优势

公司产品主要应用于智能终端、工业互联、汽车领域，通过多年的积累，公司拥有丰富且齐全的产品系列，公司产品在技术领域覆盖高性能数模混合芯片、电源管理芯片、信号链芯片，产品型号已有近1,900款。公司开发的音频功放芯片、背光驱动、呼吸灯驱动、闪光灯驱动、过压保护、GNSS低噪声放大器、FM低噪声放大器、马达驱动等各类产品在智能终端、工业互联、汽车的市场得到广泛认可，并广泛应用于知名品牌厂商的终端产品，公司研发的多款产品在半导体领域获得了诸多奖项。

（四）客户资源优势

公司拥有丰富的客户资源，已纳入众多知名品牌客户的合格供应商名录。公司产品以新智能硬件为应用核心，通过突出的研发能力、可靠的产品质量和细致的客户服务，已进入众多行业领先企业的供应链体系。公司的客户涵盖消费电子品牌如小米、OPPO、vivo、传音、TCL、联想等；汽车品牌包括比亚迪、吉利、零跑、理想、阿维塔、奇瑞、长安、现代、五菱等；以及全球科技企业如微软、Samsung、Meta、Amazon、Google等。同时，公司也与华勤技术、龙旗科技等头部ODM厂商建立了长期稳定的合作关系。公司在可穿戴设备、智能便携设备、工业控制、通信、能源、医疗等细分领域，持续拓展了Rokid、XREAL、雷鸟、影石、字节、拓竹、宇树、智元、优必选、因时科技、万拿、思格、普兆、三诺生物、深纳普思、微泰医疗、联影医疗等潜力客户。

（五）业务连续性优势

公司持续健全业务连续性规则体系，全面覆盖采购、生产、物流及IT支持等核心环节，通过常态化内部审计与应急演练确保体系有效执行。单一料号多供应商策略逐步拓展至更多核心物料，国产设备导入比例稳步提升，供应链自主可控能力持续增强。公司构建多层级数据备份架构，完善数据安全保障机制，强化数据安全防护与业务灾备恢复能力。仓储网络布局持续优化，有序增设区域分仓节点，提升物流体系韧性与市场响应效率。与此同时，公司稳步推进供应链数字化平台建设，依托实时数据监控与风险预警机制，持续提升对市场波动的预判能力与动态适应能力，为应对复杂多变的外部经营环境筑牢坚实基础。

七、研发支出变化及研发进展

公司坚持创新驱动发展战略，深耕集成电路工艺与设计前沿。在本持续督导期间，公司依托持续的研发投入与技术积淀，核心技术自主可控能力不断增强。2026年1-6月，公司研发投入28,190.05万元，较上年同期增长7.19%。

2026年1-6月，公司新增知识产权项目申请49个（其中发明专利45个），共76个知识产权项目获得授权（其中发明专利58个）。截至2026年6月30日，公司累计取得发明专利542个，实用新型专利241个，外观设计专利9个，软件著作权139

个，集成电路布图登记642个。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

（一）2021年首次公开发行股份

截至2026年6月30日止，公司累计使用募集资金274,278.78万元，其中以前年度累计使用募集资金237,888.44万元，本半年度使用募集资金36,390.34万元。截至2026年6月30日止，公司首次公开发行股份的募集资金账户余额为4,158.94万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021年8月10日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	320,104.40
其中：超募资金金额	56,712.42
减：直接支付发行费用	16,578.26
二、募集资金净额	303,526.14
减：	
以前年度已使用金额	237,888.44
本半年度使用金额	36,390.34
临时补流金额	29,748.99
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	4.90
项目结项节余资金利息补充流动资金	7,613.43
加：	
募集资金利息收入	12,278.90
三、报告期末募集资金余额	4,158.94

截至2026年6月30日，公司募投项目“智能音频芯片研发和产业化项目”“5G射频器件研发和产业化项目”“马达驱动芯片研发和产业化项目”“研发中心建

设项目”“电子工程测试中心建设项目”“发展与科技储备资金”已结项。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券

截至2026年6月30日止，公司累计使用募集资金9,104.48万元，其中本半年度使用募集资金9,104.48万元。截至2026年6月30日止，公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金账户余额为18,850.17万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

发行名称	向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2026年1月28日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	190,132.00
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	1,505.22
二、募集资金净额	188,626.78
减：	
本半年度使用金额	9,104.48
现金管理金额	161,300.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.14
加：	
募集资金利息收入	576.13
尚未支付的发行费用	51.89
三、报告期末募集资金余额	18,850.17

公司2026年1-6月募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至2026年6月30日，孙洪军直接持有公司41.80%的股份，并通过上海艾准企业管理中心（有限合伙）及其有限合伙人上海集为企业管理中心（有限合伙）间接持有公司0.01%的股份，合计持有公司41.81%的股权，为公司控股股东、实际控制人。

截至2026年6月30日公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员直接持有公司股份情况及2026年1-6月所持股份的增减变动、质押、冻结情况如下：

序号	姓名	职务	期末持股数量（股）	2026年1-6月股份增减变动数量	股份增减变动原因	质押或冻结情况
1	孙洪军	董事长、总经理、核心技术人员	97,448,396	-	不适用	无
2	郭辉	董事、核心技术人员	22,110,000	-	不适用	无
3	娄声波	董事、联席总经理	6,802,657	-	不适用	无
4	张正锋	职工代表董事	-	-	不适用	无
5	马莉黛	独立董事	-	-	不适用	无
6	胡改蓉	独立董事	-	-	不适用	无
7	程剑涛	核心技术人员（已离任）	7,464,635	-	不适用	无
8	杜黎明	副总经理、核心技术人员	4,602,180	-	不适用	无
9	张忠	核心技术人员（已离任）	6,195,120	-	不适用	无
10	吴绍夫	核心技术人员	510,250	-50,000	二级市场减持	无
11	姚炜	核心技术人员	113,223	-200	二级市场减持	无
12	陈小云	财务总监	2,704	-	不适用	无
13	余美伊	董事会秘书	1,823	-	不适用	无

注：上表中列示的持股数量及增减变动系直接持股情况。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐人认为应当发表意见的其他事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海艾为电子技术股份有限公司 2026 年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人签字： 张铁
张 铁

杜登瑞
杜登瑞

中信建投证券股份有限公司
2026年9月4日